



SPRS TECHNOLOGIES

P/N:STLP5R0-L020

Thin Film Planar Filters

## 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

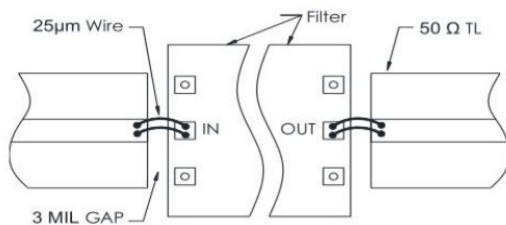
技术要求,  $T_A=25^\circ\text{C}$

| 参数     | 最小           | 典型  | 最大  | 单位  |
|--------|--------------|-----|-----|-----|
| 中心频率   |              | 2.5 |     | GHz |
| 工作频率   | DC           |     | 5.0 | GHz |
| 中心损耗   |              | 0.5 | 0.7 | dB  |
| 截止频率损耗 |              | 1.2 | 1.7 | dB  |
| 回波损耗   | 12           | 15  |     | dB  |
| 带外抑制   | @6.5-12.0GHz | 35  | 40  | dBc |

## 环境要求

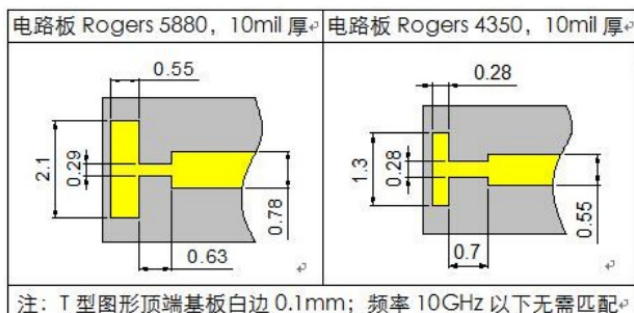
|        |                                           |     |
|--------|-------------------------------------------|-----|
| 最大输入功率 | 25                                        | dBm |
| 工作温度   | $-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$  |     |
| 储存温度   | $-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$ |     |

## 推荐装配图

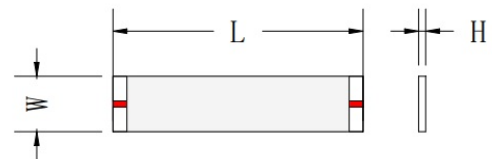


## 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 ( $6.7\text{ppm}/^\circ\text{C}$ ) ,载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

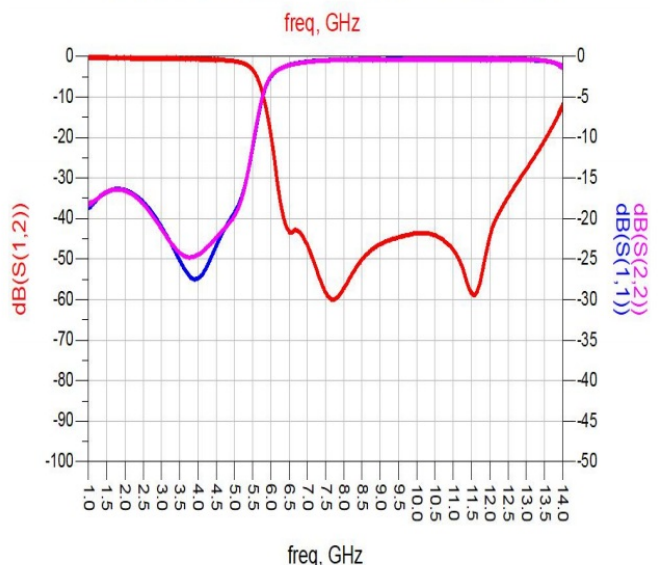
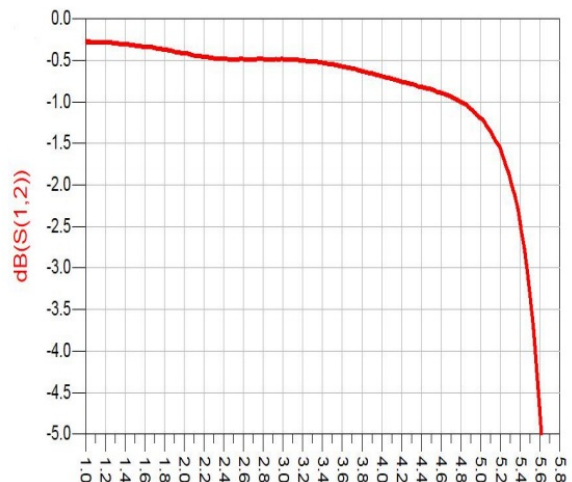


## 外形图



| 外形尺寸 | L   | W   | H     | 单位 |
|------|-----|-----|-------|----|
|      | 6.0 | 3.0 | 0.254 | mm |

## 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。